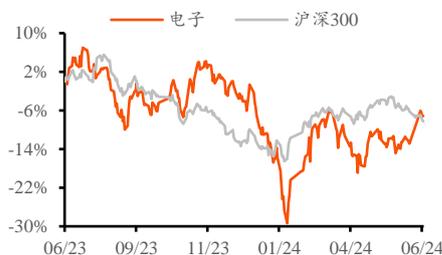


日月光推进先进封装厂房建设，中科驭数发布 DPU  
——电子行业周报（2024.06.17-2024.06.21）

增持(维持)

行业： 电子  
日期： 2024年06月24日  
分析师： 陈宇哲  
E-mail: chenyzhe@yongxings.com  
SAC 编号： S1760523050001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

相关报告:

- 《三星电子出 AI 解决方案，骁龙 6s Gen3 提升 AI 性能》  
——2024 年 06 月 17 日
- 《Gaudi 3 芯片售价公布，英特尔或重视玻璃基板封装》  
——2024 年 06 月 11 日
- 《康宁推进玻璃基板工艺，台积电称 3D 封装日趋重要》  
——2024 年 06 月 03 日

核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

**玻璃基板:** 电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core, 玻璃基板产业或将加速发展。电气硝子此次开发出的 GC Core 基板芯材由玻璃粉末和陶瓷粉末低温共烧而成, 拥有陶瓷的部分性质, 不易产生裂纹, 可直接使用 CO2 激光器钻孔, 降低量产成本。我们认为, 玻璃基板或将适合 HPC、AI 领域的芯片, 相关产业链有望持续受益。

**铜连接:** GB200 采用铜缆连接, 预估 2024 年出货量为 42 万片, 相关产业链或将受益。GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink 技术, 拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆。GB200 在 2024 年预估出货量为 42 万片, 2025 年将达到 200 万片。我们认为, GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求, 相关产业链有望持续受益。

**先进封装:** 日月光推进先进封装厂房建设, 相关产业链有望持续收益。日月光投控旗下日月光半导体宣布, 与日月光旗下宏璟建设在高雄兴建 K28 厂, 预计 2026 年第四季度完工, 布局先进封装终端测试以及人工智能 (AI) 芯片高性能计算。我们认为, 先进封装在算力时代重要性逐步凸显, 相关产业链有望持续受益。

**算力芯片:** 中科驭数国内首颗量产全功能 DPU 算力芯片, 算力芯片产业链有望持续收益。K2 Pro 强化复杂业务支持, 复杂服务网格性能从 400 微秒降至 30 微秒以内; 在 DPU 复杂场景下能耗降低 30%。我们认为, AI 推动算力需求攀升, 相关产业链有望持续受益。

市场行情回顾

本周 (6.17-6.21), A 股申万电子指数上涨 1.86%, 整体跑赢沪深 300 指数 3.15pct, 跑赢创业板综指数 3.62pct。申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为: 消费电子(3.11%)、半导体(3.08%)、其他电子 II(1.35%)、元件(0.34%)、光学光电子(-0.93%)、电子化学品 II(-2.05%)。从海外市场指数表现来看, 整体继续维持强势, 海内外指数涨跌幅由高到低分别为: 台湾电子(4.25%)、申万电子(1.86%)、纳斯达克(0%)、恒生科技(-0.17%)、道琼斯美国科技(-0.57%)、费城半导体(-1.07%)。

投资建议

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI 为核心的算力芯片产业链。

**玻璃基板:** 受益于算力芯片技术发展, 产业链有望迎来加速成长, 建议关注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等;

**铜连接:** 受益于英伟达 GB200 出货顺利, 产业链需求有望增长, 建议关注胜蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份;

**先进封装:** 受益于半导体大厂持续布局先进封装, 产业链有望迎来加速成长, 建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等;

**算力芯片:** 受益于算力需求持续攀升, 有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。

风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

## 正文目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 本周核心观点及投资建议 ..... | 3  |
| 2. 市场回顾 .....        | 5  |
| 2.1. 板块表现 .....      | 5  |
| 2.1. 个股表现 .....      | 7  |
| 3. 行业新闻 .....        | 8  |
| 4. 公司动态 .....        | 9  |
| 5. 公司公告 .....        | 11 |
| 6. 风险提示 .....        | 12 |

## 图目录

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (6.17-6.21) ..... | 5 |
| 图 2: A 股申万二级行业涨跌幅情况 (6.17-6.21) ..... | 5 |
| 图 3: A 股申万三级行业涨跌幅情况 (6.17-6.21) ..... | 6 |
| 图 4: 海内外指数涨跌幅情况 (6.17-6.21) .....     | 6 |

## 表目录

|   |    |
|---|----|
| 表 1: 电子行业 (申万) 个股本周涨跌幅前后 10 名 (6.17-6.21) ..... | 7  |
| 表 2: 电子行业本周重点公告 (6.17-6.21) .....               | 11 |

## 1. 本周核心观点及投资建议

### 核心观点:

**玻璃基板:** 电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core, 玻璃基板产业或将加速发展。据 IT 之家报道, 日本电气硝子近日宣布推出新型半导体基板材料 GC Core。相较于有机基板, 玻璃基板更为坚固, 表面更为光滑, 更便于承载超精细电路, 是先进封装领域的明星技术。电气硝子此次开发出的 GC Core 基板芯材由玻璃粉末和陶瓷粉末低温共烧而成, 拥有陶瓷的部分性质, 不易产生裂纹, 可直接使用 CO2 激光器钻孔, 降低量产成本。我们认为, 玻璃基板或将适合 HPC、AI 领域的芯片, 相关产业链有望持续受益。

**铜连接:** GB200 采用铜缆连接, 预估 2024 年出货量为 42 万片, 相关产业链或将受益。根据财联社报道, 黄仁勋介绍, GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink 技术, 拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆, 展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其数据中心设备的耗电量, 使用铜而不是光学器件, 可以为每个服务器机架节省 20 千瓦的电力。根据科创板日报报道, 从 CoWoS 先进封装产能研判, 2024 年下半年估计将有 42 万颗 GB200 送至下游市场, 2025 年产出量上看 150 万至 200 万颗。我们认为, GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求, 相关产业链有望持续受益。

**先进封装:** 日月光推进先进封装厂房建设, 相关产业链有望持续收益。根据科创板日报报道, 日月光投控旗下日月光半导体宣布, 与日月光旗下宏璟建设在高雄兴建 K28 厂, 预计 2026 年第四季度完工, 布局先进封装终端测试以及人工智能 (AI) 芯片高性能计算。我们认为, 先进封装在算力时代重要性逐步凸显, 相关产业链有望持续受益。

**算力芯片:** 中科驭数发布 K2 Pro, 为国内首颗量产全功能 DPU 算力芯片, 算力芯片产业链有望持续收益。根据 IT 之家报道, 中科驭数 2024 产品发布会 19 日在北京中关村展示中心举办。发布会上, 中科驭数第三代 DPU 芯片 K2 Pro 正式发布, 是目前国内首颗量产全功能 DPU 算力芯片, 为未来数据中心和云原生环境定制优化。K2 Pro 强化复杂业务支持, 集成网络卸载、流表卸载、存储卸载及 RDMA 网络卸载等多类型硬件卸载引擎, 复杂服务网格性能从 400 微秒降至 30 微秒以内; 在 DPU 复杂场景下能耗降低 30%, 实现低功耗运行。我们认为, AI 推动算力需求攀升, 相关产业链有望持续受益。

### 投资建议:

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI 为核心的算力芯片产业链。

**玻璃基板：**受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建议关注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等；

**铜连接：**受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，建议关注胜蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份；

**算力芯片：**受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；

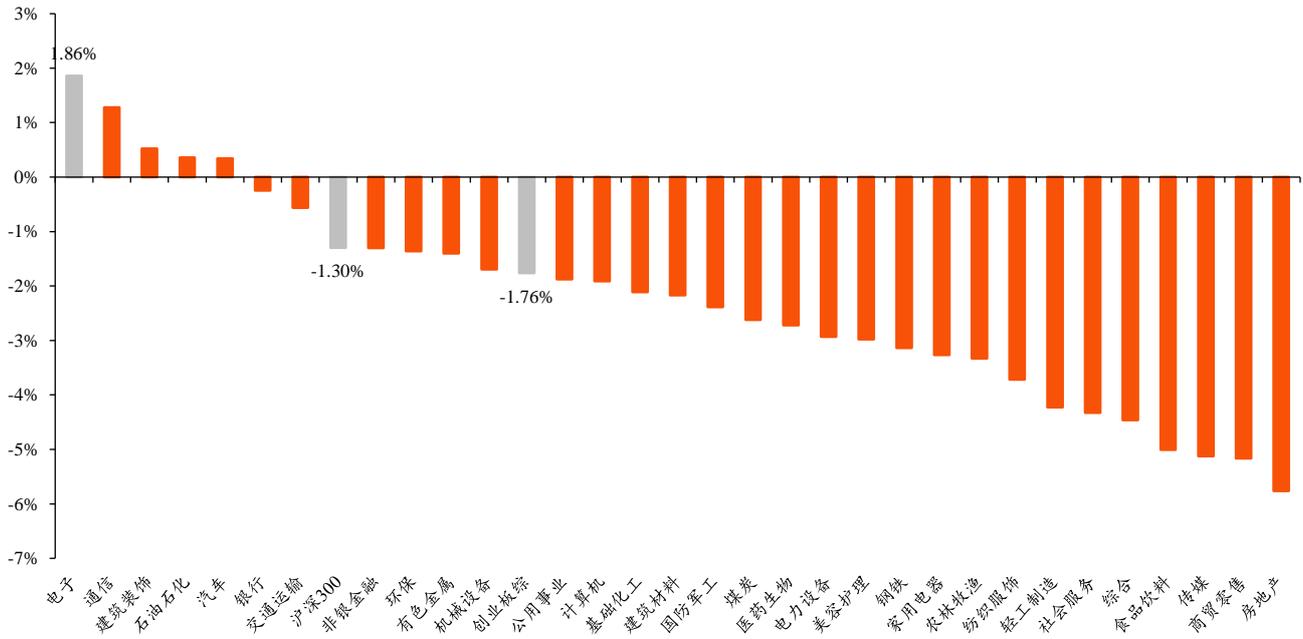
**先进封装：**受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等。

## 2. 市场回顾

### 2.1. 板块表现

本周（6.17-6.21），A股申万电子指数上涨1.86%，板块整体跑赢沪深300指数3.15pct，跑赢创业板综指数3.62pct。在申万31个一级子行业中，电子板块周涨跌幅排名为第1位。

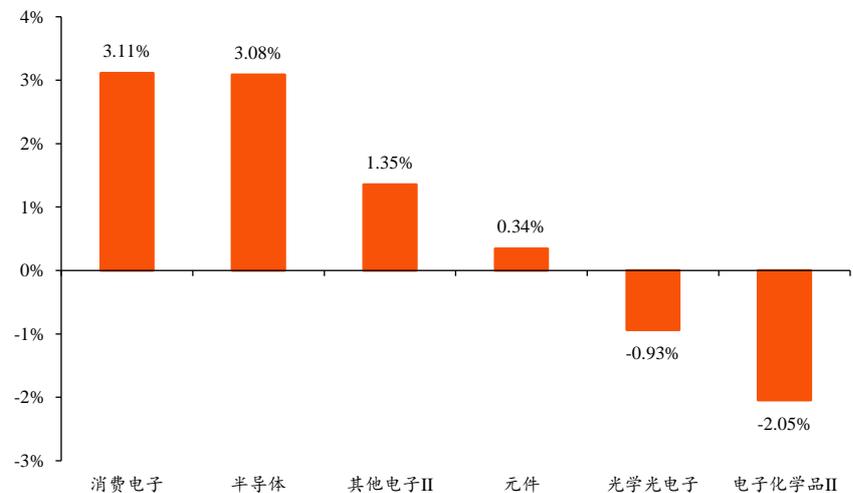
图1:A股申万一级行业涨跌幅情况(6.17-6.21)



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（6.17-6.21）申万电子二级行业中，消费电子板块上涨3.11%，表现较好；电子化学品II板块下跌2.05%，表现较差。电子二级行业涨跌幅由高到低分别为：消费电子(3.11%)、半导体(3.08%)、其他电子II(1.35%)、元件(0.34%)、光学光电子(-0.93%)、电子化学品II(-2.05%)。

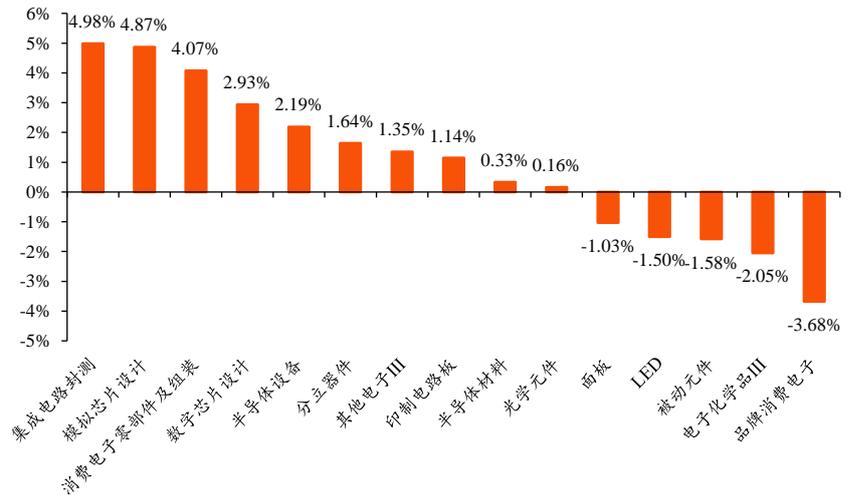
图2:A股申万二级行业涨跌幅情况(6.17-6.21)



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

本周（6.17-6.21）申万电子三级行业中，集成电路封测板块上涨 4.98%，表现较好；品牌消费电子板块下跌 3.68%，表现较差。表现靠前的板块分别为：集成电路封测(4.98%)、模拟芯片设计(4.87%)、消费电子零部件及组装(4.07%)。表现靠后的板块分别为：品牌消费电子(-3.68%)、电子化学品III(-2.05%)、被动元件(-1.58%)。

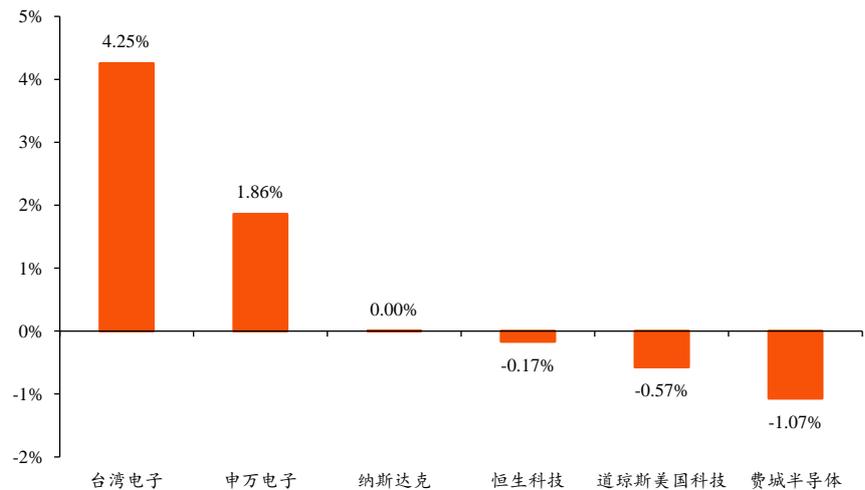
图3:A股申万三级行业涨跌幅情况（6.17-6.21）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势。本周（6.17-6.21），海内外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾电子(4.25%)、申万电子(1.86%)、纳斯达克(0%)、恒生科技(-0.17%)、道琼斯美国科技(-0.57%)、费城半导体(-1.07%)。

图4:海内外指数涨跌幅情况（6.17-6.21）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

## 2.1. 个股表现

本周（6.17-6.21）个股涨跌幅前十位分别为：金溢科技（+46.85%）、晶华微（+32.91%）、东晶电子（+31.75%）、气派科技（+30.04%）、奥尼电子（+27.48%）、杰美特（+25.71%）、灿瑞科技（+21.15%）、慧为智能（+19.38%）、敏芯股份（+18.7%）、晶方科技（+16.87%）。个股涨跌幅后十位分别为：超华科技（-21.82%）、英力股份（-17.06%）、乐凯新材（-17.04%）、贝仕达克（-15.52%）、海能实业（-13.97%）、雷曼光电（-12.04%）、雅葆轩（-11.5%）、ST 宇顺（-10.71%）、安路科技（-10.49%）、贤丰控股（-10.42%）。

**表1:电子行业（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（6.17-6.21）**

| 周涨跌幅前 10 名 |      |        | 周涨跌幅后 10 名 |       |         |
|------------|------|--------|------------|-------|---------|
| 证券代码       | 股票简称 | 周涨幅(%) | 证券代码       | 股票简称  | 周跌幅(%)  |
| 002869.SZ  | 金溢科技 | 46.85% | 002288.SZ  | 超华科技  | -21.82% |
| 688130.SH  | 晶华微  | 32.91% | 300956.SZ  | 英力股份  | -17.06% |
| 002199.SZ  | 东晶电子 | 31.75% | 300446.SZ  | 乐凯新材  | -17.04% |
| 688216.SH  | 气派科技 | 30.04% | 300822.SZ  | 贝仕达克  | -15.52% |
| 301189.SZ  | 奥尼电子 | 27.48% | 300787.SZ  | 海能实业  | -13.97% |
| 300868.SZ  | 杰美特  | 25.71% | 300162.SZ  | 雷曼光电  | -12.04% |
| 688061.SH  | 灿瑞科技 | 21.15% | 870357.BJ  | 雅葆轩   | -11.50% |
| 832876.BJ  | 慧为智能 | 19.38% | 002289.SZ  | ST 宇顺 | -10.71% |
| 688286.SH  | 敏芯股份 | 18.70% | 688107.SH  | 安路科技  | -10.49% |
| 603005.SH  | 晶方科技 | 16.87% | 002141.SZ  | 贤丰控股  | -10.42% |

资料来源：Wind, 甬兴证券研究所

### 3. 行业新闻

#### 日月光宣布建设高雄 K28 厂，扩充先进封装产能

6月21日消息，根据科创板日报报道，日月光投控旗下日月光半导体宣布，与日月光旗下宏璟建设在高雄兴建K28厂，预计2026年第四季度完工，布局先进封装终端测试以及人工智能（AI）芯片高性能计算。

资料来源：（科创板日报）

#### 中科驭数发布 K2 Pro，为国内首颗量产全功能 DPU 算力芯片

6月20日消息，根据IT之家报道，中科驭数2024产品发布会19日在北京中关村展示中心举办。发布会上，中科驭数第三代DPU芯片K2 Pro正式发布，是目前国内首颗量产全功能DPU算力芯片，为未来数据中心和云原生环境定制优化。K2 Pro强化复杂业务支持，集成网络卸载、流表卸载、存储卸载及RDMA网络卸载等多类型硬件卸载引擎，复杂服务网络性能从400微秒降至30微秒以内；在DPU复杂场景下能耗降低30%，实现低功耗运行。

资料来源：（IT之家）

#### 电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core

6月12日消息，根据IT之家报道，日本电气硝子近日宣布推出新型半导体基板材料GC Core。相较于有机基板，玻璃基板更为坚固，表面更为光滑，更便于承载超精细电路，是先进封装领域的明星技术。英特尔、三星等一系列重要半导体企业均已在这个方向发力。然而，玻璃材质本身的脆性又在一定程度上限制了玻璃基板的应用：玻璃基板的最大优势是其支持构建TGV（玻璃通孔）垂直通道，但目前使用常见的CO2激光器在玻璃基板上钻孔时容易出现裂纹，最终可能导致基板破裂。如果想避免这一问题，则要改用激光改性和蚀刻处理来打孔。这一方案不仅技术上更为麻烦，也将引入额外开支。电气硝子此次开发出的GC Core基板芯材由玻璃粉末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部分性质，不易产生裂纹，可直接使用CO2激光器钻孔，降低量产成本。

资料来源：（科创板日报）

#### GB200 采用 NVLink 技术，展现铜缆连接在高性能计算领域的潜力

3月29日消息，根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英里的NVLink铜缆，展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其数据中心设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架节省20千瓦的电力。

资料来源：（财联社）

## 4. 公司动态

### 【芯联集成】公司会不断推进机器人领域的发展

6月18日消息，芯联集成在投资者互动平台表示，2023年公司在AI服务器、数据中心等应用方向发布了面向数据中心服务器的55纳米高效率电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点。2024年，公司未来将聚焦在新能源和AI两大方向。AI方向应用领域主要覆盖电源管理和机器人市场。未来公司将进一步加强AI领域的技术布局和市场拓展，汽车智能化、高效电源管理芯片的产品导入和市场渗透，以及推进智能传感器芯片在机器人领域的应用。

资料来源：（投资者互动平台）

### 【裕太微】公司目前已成功跨越行业周期带来的低谷期

6月18日消息，裕太微在投资者互动平台表示，公司作为中国大陆地区极少数已经规模量产的以太网物理层芯片供应商，成立时间较短，产品系列尚在开拓期，需要一定的时间完成产品研发的积淀。2020年，百兆网通以太网物理层芯片出货放量，并结合部分刚量产的单口千兆网通以太网物理层芯片，实现营收收入金额为1,295.08万元。由此，公司开始进入小批量第一轮研发收获期。2023年下半年公司进入第二轮研发收获期，三款新品于量产元年逆势实现营业收入金额为4,199.10万元，预计2024年三款新品将进一步放量。公司目前已进入第三轮研发投入期，该轮次研发投入金额较大，研发投入周期较长，研发产品难度系数大幅提升。该轮次核心研发投入为补充2.5G系列网通产品、24口及以下网通交换机芯片、5G/10G网通以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载高速视频传输芯片、车载网关芯片。这一系列产品将陆续于2024年到2026年量产出货，为后续营收份额的提升做出贡献。从2024年第一季度的整体数据情况来看，公司目前已成功跨越行业周期带来的低谷期，结合研发产品已逐步出产并放量，2024年第一季度产品销量和销售额同比环比均为增长状态，预计后续几年将进入新一轮增长期。

资料来源：（投资者互动平台）

### 【金海通】公司分选机可用于玻璃基板技术

6月18日消息，金海通在投资者互动平台表示，玻璃基板作为一种新型的封装基板材料，它在半导体先进封装领域具有重要的应用。相较于传统的有机基板，玻璃基板在先进封装领域具有较为显著的优点。先进封装是指半导体产品在封装过程中使用了先进封装工艺技术，在多种半导体产品的封装过程中都可应用。公司产品集成电路测试分选机，是在芯片产品设计验证环节和成品检测环节，配合测试机对芯片封装后的成品进行测试

分选。使用先进封装技术的芯片，其成品可以使用公司的测试分选机进行测试分选。

资料来源：（投资者互动平台）

## 5. 公司公告

**表2:电子行业本周重点公告 (6.17-6.21)**

| 日期         | 公司   | 公告类型 | 要闻   |
|------------|------|------|--|
| 2024/06/17 | 恒玄科技 | 利润分配 | 公司总股本为 120,034,708 股，以总股本为基准，扣减回购专用证券账户中股份总数 860,708 股，实际参与利润分配的股本总数为 119,174,000 股，每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 19,067,840.00 元（含税）。          |
| 2024/06/18 | 长电科技 | 利润分配 | 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,789,414,570 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 178,941,457.00 元。   |
| 2024/06/18 | 通富微电 | 利润分配 | 参与本次权益分派的总股本基数变更为 1,517,596,912 股，全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），本次现金分红总额为 18,211,162.94 元。   |
| 2024/06/19 | 蓝思科技 | 利润分配 | 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（4,983,069,781 股）扣除公司回购专用账户中的回购股份（42,527,893 股）为基数（4,940,541,888 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），现金分红总额为 1,482,162,566.40 元。 |
| 2024/06/20 | 中颖电子 | 利润分配 | 以公司现有总股本 342,028,361 股剔除已回购股份 1,912,435 股后的 340,115,926 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税），合计派发现金红利 68,023,185.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。        |

资料来源：Wind，甬兴证券研究所

## 6. 风险提示

### 1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

### 2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

### 3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

## 分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

## 公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

## 投资评级体系与评级定义

|                |   |
|----------------|---|
| <b>股票投资评级：</b> | 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。             |
| 买入             | 股价表现将强于基准指数 20%以上   |
| 增持             | 股价表现将强于基准指数 5-20%   |
| 中性             | 股价表现将介于基准指数±5%之间  |
| 减持             | 股价表现将弱于基准指数 5%以上  |
| <b>行业投资评级：</b> | 分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。 |
| 增持             | 行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数  |
| 中性             | 行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平   |
| 减持             | 行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数  |

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

### 投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

## 特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司（以下简称“本公司”）或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

## 版权声明

本报告版权归属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

### 重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。